

2021-2027年中国半导体用 环氧塑封料市场发展现状与投资前景评估报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2021-2027年中国半导体用环氧塑封料市场发展现状与投资前景评估报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/jiancai/1143824E1M.html>

报告价格：印刷版：RMB 8000 电子版：RMB 8000 印刷版+电子版：RMB 8200

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国半导体用环氧塑封料市场发展现状与投资前景评估报告》共八章。首先介绍了半导体用环氧塑封料行业市场发展环境、半导体用环氧塑封料整体运行态势等，接着分析了半导体用环氧塑封料行业市场运行的现状，然后介绍了半导体用环氧塑封料市场竞争格局。随后，报告对半导体用环氧塑封料做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体用环氧塑封料行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体用环氧塑封料产业有个系统的了解或者想投资半导体用环氧塑封料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 报告目录：第一章环氧塑封料产品概述1.1环氧塑封料产品定义1.2环氧塑封料的发展历程与产业现况1.3环氧塑封料技术发展趋势1.4环氧塑封料在半导体产业中的重要地位 第二章环氧塑封料的组成、品种分类及生产过程2.1环氧塑封料产品组成2.2环氧塑封料产品品种分类2.2.1按其主要组成2.2.2按其专业用途2.2.3按其施工条件2.2.4按其包装形态2.3环氧塑封料制作过程2.4环氧塑封料产品性能2.4.1未固化物理性能2.4.2固化物理性能2.4.3机械性能 第三章环氧塑封料的应用及其主要市场领域3.1ic封装的塑封成形工艺过程3.1.1ic封装塑封成形的工艺过程3.1.2ic封装塑封成形的工艺要点3.1.3ic封装塑封成形的质量保证3.2环氧塑封料的应用领域 第四章全球半导体封测产业概况及市场分析4.1世界半导体封装业发展特点4.2世界半导体封装产品的主要生产制造商4.3世界半导体封装业的发展现状4.3.12019年世界半导体产业与市场概况4.3.2世界封测产业与市场概况4.4世界封测产业的发展总趋势4.5世界封测生产值统计 第五章我国半导体封测产业概况及市场分析5.12019年我国半导体产业发展状况5.2我国集成电路封测业发展现况5.2.1我国集成电路产业发展5.2.2我国集成电路封测产业发展现况5.2.2.1我国ic封测产业市场规模现况5.2.2.2我国ic封测厂家分布及产能5.2.2.3我国ic封测业的骨干生产企业情况5.2.2.4我国ic封测业内资企业在近期的技术发展5.3我国半导体分立器件封测业发展现况5.3.1我国半导体分立器件生产现况5.3.2我国半导体分立器件行业发展特点5.3.3我国半导体分立器件产业地区分布及市场结构5.3.4我国半导体分立器件生产厂家情况5.3.5我国半导体分立器件市场发展前景 第六章世界环氧塑封料产业的生产与技术现状6.1世界环氧塑封料生产与市场总况6.2世界环氧塑封料主要生产企业概述6.3日本环氧塑封料生产厂家现状6.3.1住友电木（sumitomobakelite）6.3.2日东电工（nittodenko）6.3.3日立化成（hitachichemical）6.3.4松下电工株式会社（matsushitaelectric）6.3.5信越化学工业（shin-etsuchemical）6.3.6京瓷化学（kyocerachemical）6.4台湾长春人造树脂现状6.5韩国环氧

塑封料生产厂家现状6.5.1三星SDI6.5.2韩国kcc6.6汉高集团（hysol）塑封料生产现状 第七章我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求7.1我国环氧塑封料业的发展现状7.2我国环氧塑封料业生产情况7.3我国环氧塑封料业技术水平现况7.3.1环氧塑封料的工艺选择7.3.2塑封料性能对器件可靠性的影响7.4我国国内环氧塑封料的市场需求情况7.5未来几年我国环氧塑封料行业的市场发展趋势预测7.6我国环氧塑封料的主要生产厂家情况7.6.1汉高华威电子有限公司7.6.2长兴电子材料(昆山)有限公司7.6.3南通住友电木有限公司7.6.4日立化成工业（苏州）有限公司7.6.5北京科化新材料科技有限公司7.6.6佛山市亿通电子有限公司7.6.7浙江恒耀电子材料有限公司7.6.8江苏中鹏电子有限公司7.6.9广州市华塑电子有限公司7.6.10松下电工（上海）电子材料有限公司7.6.11北京中新泰合电子材料科技有限公司7.6.12长春封塑料（常熟）有限公司7.6.13无锡创达电子有限公司7.6.14广东榕泰实业股份有限公司 第八章环氧塑封料生产主要原材料及其需求（）8.1emc用环氧树脂8.1.1emc对环氧树脂原料的要求8.1.2世界及我国环氧树脂业发展现状8.1.3国内环氧树脂产业的原材料供应情况8.1.3.1双酚a8.1.3.2环氧氯丙烷（ech）8.1.4绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况8.2emc用硅微粉8.2.1emc对硅微粉原料的要求8.2.2emc用硅微粉产品概述8.2.3国外emc用硅微粉产品生产的现况8.2.3.1日本emc用硅微粉的生产现况8.2.3.2北美emc用硅微粉的生产现况8.2.3.3欧洲emc用硅微粉的生产现况8.2.4国内emc用硅微粉产品生产的现况 部分图表目录图表：2019年半导体产业资本支出额企业占比图表：2019年部分封测企业收入（仅包含纯代工封装企业）图表：集成电路产业结构图表：2015-2019年全球半导体设备销售收入图表：2015-2019年中国半导体设备销售占比图表：2015-2019年中国ic封测产业销售规模图表：2015-2019年中国半导体分立器件行业产量图表：2015-2019年中国半导体分立器件市场规模图表：我国半导体分立器件生产厂家图表：2015-2019年全球环氧塑封料行业产量图表：2015-2019年全球环氧塑封料行业市场规模图表：2019年住友电木环氧塑封料产量对比图表：2019年日东电工环氧塑封料产量对比图表：2019年日立化成环氧塑封料产量对比图表：2019年松下电工株式会社环氧塑封料产量对比图表：2019年信越化学工业环氧塑封料产量对比图表：2019年京瓷化学环氧塑封料产量对比图表：2019年长春人造树脂环氧塑封料产量对比图表：2019年三星SDI环氧塑封料产量对比图表：2019年韩国kcc环氧塑封料产量对比图表：2019年汉高集团环氧塑封料产量对比图表：2015-2019年中国环氧塑封料行业产量图表：2015-2019年中国环氧塑封料行业需求量图表：2021-2027年中国环氧塑封料行业市场规模预测图表：2019年汉高华威电子有限公司环氧塑封料产量对比图表：2019年长兴电子材料(昆山)有限公司环氧塑封料产量对比图表：2019年南通住友电木有限公司环氧塑封料产量对比图表：2019年日立化成工业（苏州）有限公司环氧塑封料产量对比图表：2019年北京科化新材料科技有限公司环氧塑封料产量对比更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/jiancai/1143824E1M.html>